



平成 23 年 9 月 7 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 S U M C O
代表者名 取締役社長 田 口 洋 一
(コード： 3 4 3 6 東証第一部)
問合せ先 広報・IR室長 濫 谷 博 史
(TEL. 03-5444-3915)

当期第 2 四半期連結累計期間の予想値と決算値との差異に関するお知らせ

平成 23 年 3 月 11 日に公表しました平成 24 年 1 月期第 2 四半期連結累計期間の業績予想値と、本日公表しました当該連結累計期間の実績値に差異が生じましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 平成 24 年 1 月期第 2 四半期連結累計期間の業績予想数値と実績値との差異 (平成 23 年 2 月 1 日～平成 23 年 7 月 31 日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	136,000	4,000	△2,000	△2,500	△9.70
実 績 値 (B)	134,938	5,426	1,536	△1,362	△5.29
増 減 額 (B－A)	△1,062	1,426	3,536	1,138	－
増 減 率 (%)	△0.8	35.7	－	－	－
(ご参考)前期第 2 四半期実績 (平成 23 年 1 月期第 2 四半期)	142,337	△1,124	△9,909	△8,394	△32.57

2. 差異の理由

当第 2 四半期連結累計期間における半導体用シリコンウェーハの出荷は、携帯情報端末などの需要拡大が続き、また、東日本大震災による緊急需要へ全社を挙げて対応したことから、3 月時点の想定より増加しました。一方、太陽電池用シリコンウェーハは、市場環境が急速に悪化し、出荷数量が急減しました。

この結果、売上高は前回予想値を下回りましたが、営業利益、経常利益、および当期純利益につきましては、震災による特別損失を計上したものの、半導体用シリコンウェーハの拡販により、前回予想値から増益となりました。

以 上